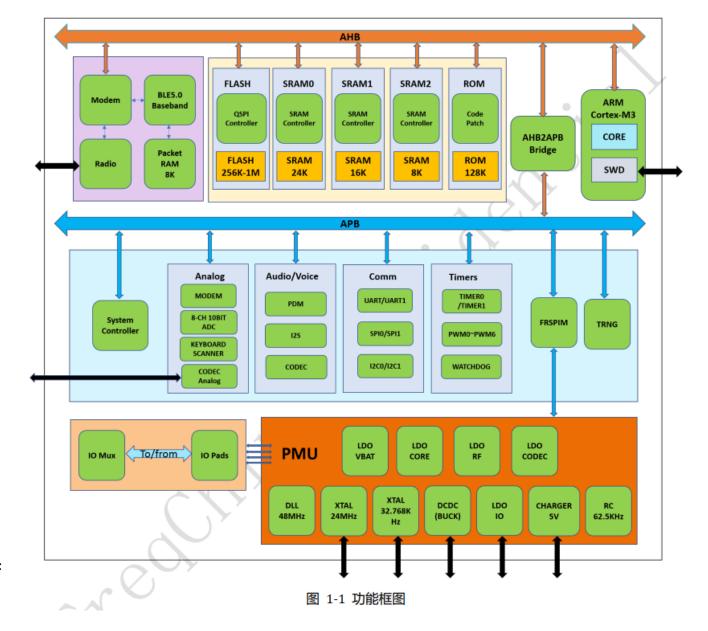




FR801xH硬件资源

MCU特性

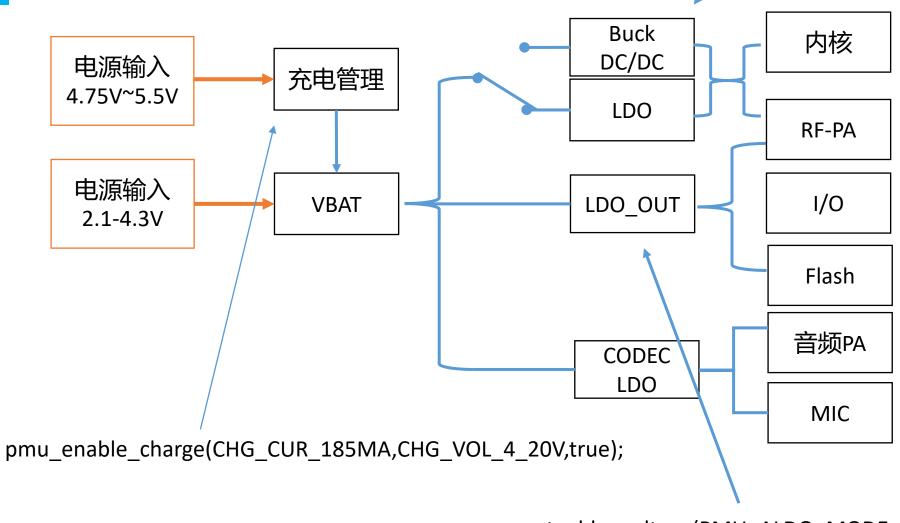
- ARM Cotex-M3内核
- 48MHz主频
- 48KB SRAM
- 256KB/512KB/1MB Flash
- 两路UART
- Audio Codec
- 支持2路数字MIC
- 1路模拟MIC
- 1路SPI
- 2路I2C
- Timer
- 6路PWM
- 内置RTC时钟
- 4路10位SAR ADC
- 所有I/O支持唤醒
- I/O内置上拉电阻 (50K) , 默认浮空状态
- 充电电流最大支持200mA,充满电压支持4.3V
- BLE V5.1标准



pmu_set_sys_power_mode(PMU_SYS_POW_BUCK);
FR801xH电源结构

Buck
DC/DC

内核

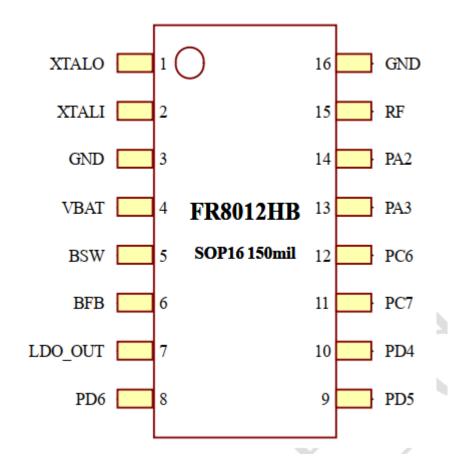


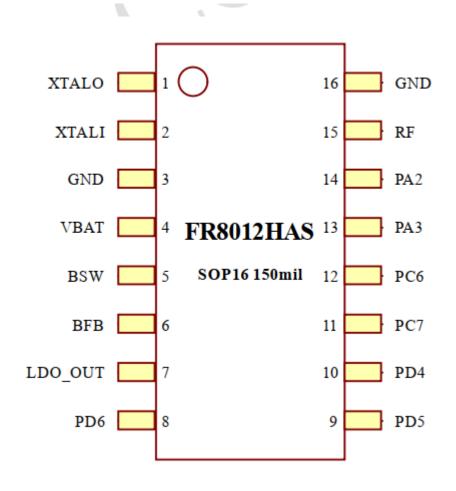
pmu_set_aldo_voltage(PMU_ALDO_MODE_NORMAL,PMU_ALDO_VOL_3_1);



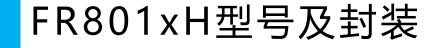
FR801xH型号及封装

1、FR8012HB/HA

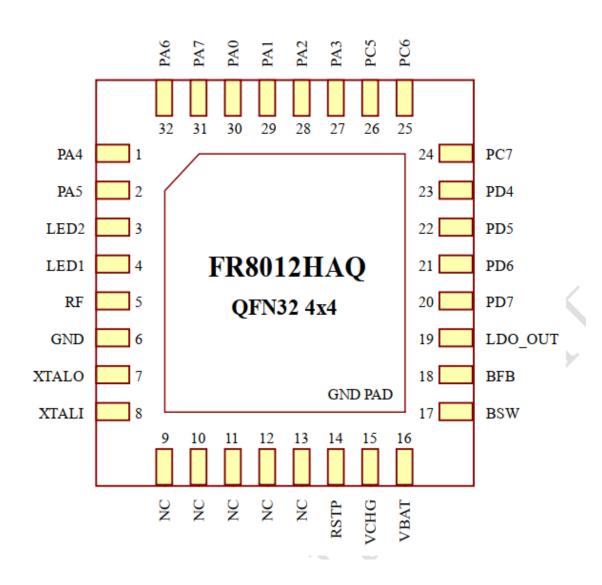








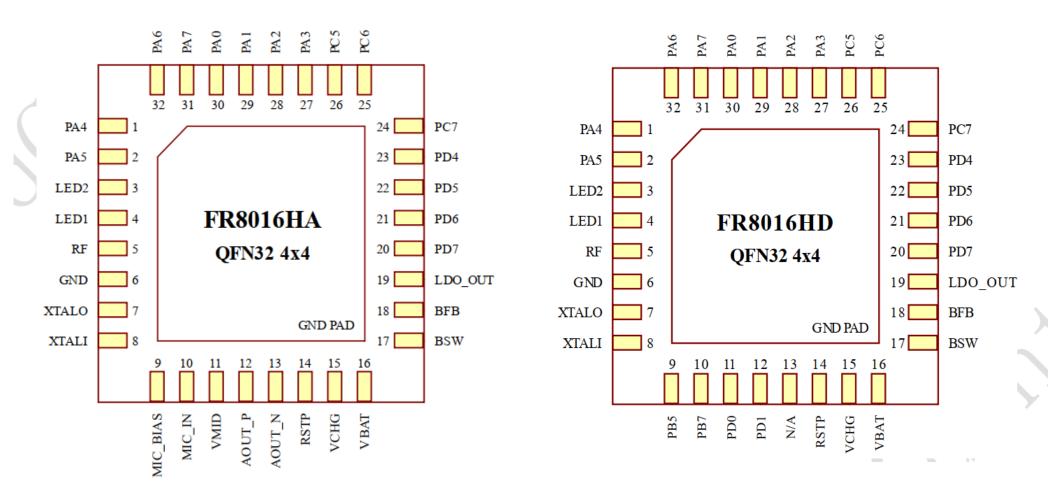
2、FR8012HAQ





FR801xH型号及封装

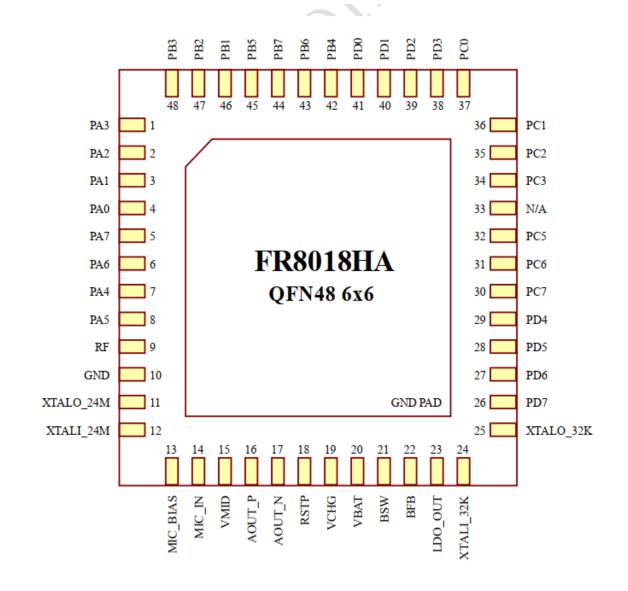
3、FR8016HA/HD





FR801xH型号及封装

4、FR8018HA/HD





FR801xH应用设计注意事项

1、电源部分和时钟

- A、芯片供电输入只能从VBAT脚输入,输入电压范围为2.1V~4.3V。支持锂电池、纽扣电池、干电池供电。
- B、芯片电源滤波电容在PCB Layout时靠近芯片引脚放置,滤波电容地就近接芯片底部焊盘地。
- C、应用中不使用的引脚悬空。
- D、DC/DC Buck降压电感选用10uH、额定电流≥50mA、Rdc值小于1Ω、频率≥ 10MHz。可使用叠层电感、线绕电感。
- E、VCHG脚滤波电容选用耐压≥ 25V; VBAT脚滤波电容选用耐压≥ 10V; 其它电源脚滤波电容耐压选用6.3V。
- F、LDO_OUT输出电压可配置,最大支持80mA输出电流,可供外设使用。
- G、复位脚RSTP为高电平复位。触发复位电平≥0.8V,时间≥3uS。
- H、VBAT脚内置电压检测。
- E、晶振选用24MHz、CL值≤12pF、10ppm。



FR801xH应用设计注意事项

2、I/O部分

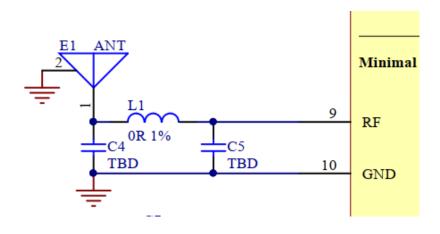
- A、PA2 加上拉电阻,稳定系统启动。
- B、产品需要过静电2KV以上测试,接口处使用的I/O需增加TVS管或者ESD管。
- C、所有I/O上电默认浮空状态。需要上电默认输出低电平,需在I/O增加下拉电阻。
- D、软件烧录口使用串口(PA2、PA3)PCB Layout需留VBAT、PA2、PA3、GND测试点。
- E、PD4~PD7支持SAR ADC。
- F、I/O支持矩阵按键。PD0-PD7为矩阵按键行,PA0-PA7、PB0-PB7、PC0-PC3为矩阵按键列。
- G、LED灯口只能做输出,可配置输出高、低电平、PWM。
- H、PC6、PC7可用于Jlink调试口。
- I、I/O驱动电流8mA。

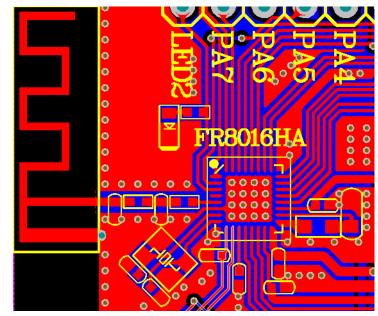


FR801xH应用设计注意事项

3、RF部分

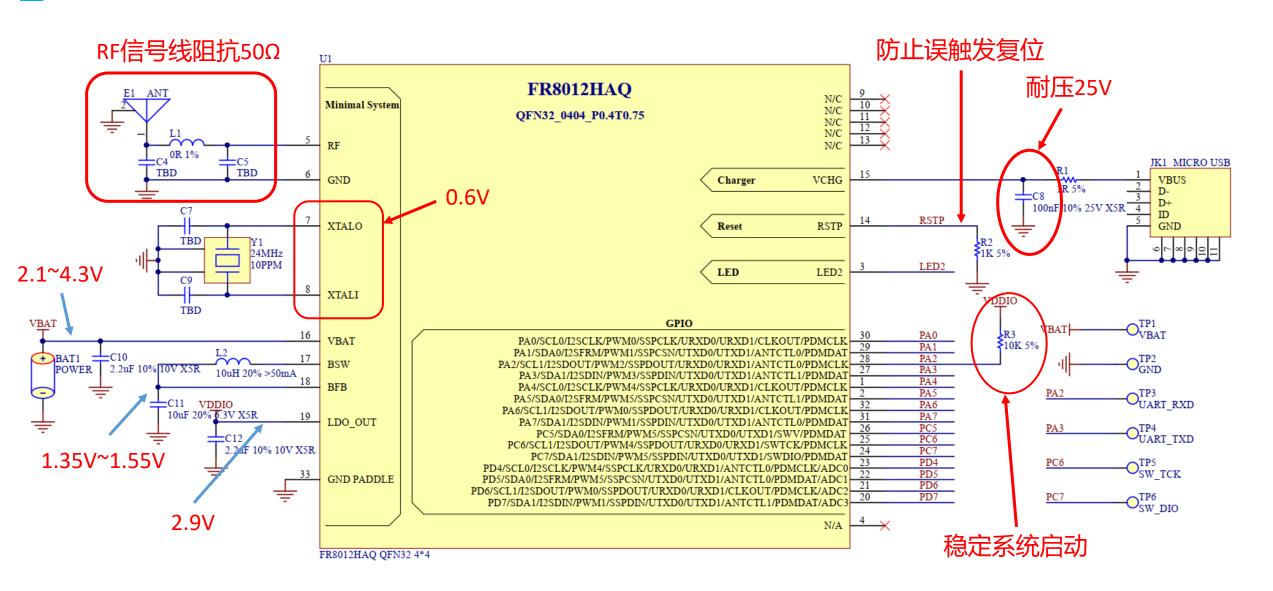
- A、天线必须放置在板边,严禁被GND包裹,且正反面需要净空区,远离金属和电池,远离高频噪声源。
- B、射频线需要走50ohm阻抗。走线尽量短和宽,不要有过孔,最好和芯片同层。不能走直角,尽量使用圆弧 走线或135°角走线,走线宽度保持一致,避免分支走线,周围地孔屏蔽。确保射频走线底层有完整的地平面, 并且与芯片底部的GND相连。
- C、天线与芯片之间预留π形匹配电路,靠近芯片RF脚放置,用于天线匹配,天线匹配阻抗往50Ω方向调,元件参数值根据天线和PCB布局实测后确定。







FR801xH硬件调试







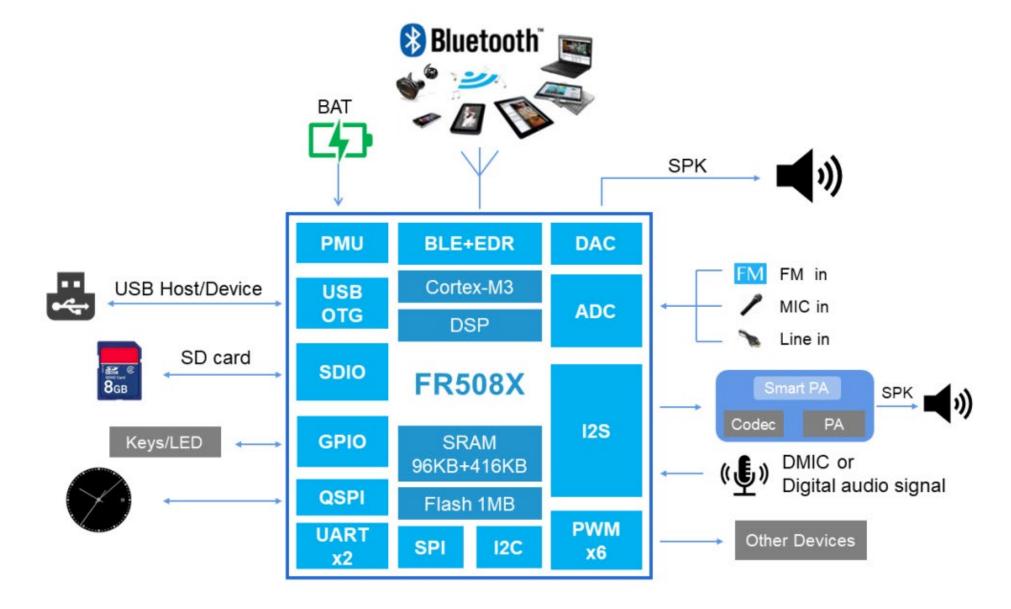
MCU特性

- ARM Cotex-M3内核+DSP
- 96KB+416KB SRAM
- 1MB Flash
- 两路UART(CM3 1路+DSP 1路)
- Audio Codec
- 支持4路数字MIC
- 1路模拟MIC
- 1路SPI
- 两路I2C
- Timer
- 6路PWM
- 内置RTC时钟
- 4路10位SAR ADC
- 所有I/O支持唤醒
- I/O内置上、下拉电阻(上拉50K、下拉30K), 默认浮空状态
- 充电电流最大支持200mA, 充满电压支持4.3V
- 双模蓝牙V5.0标准

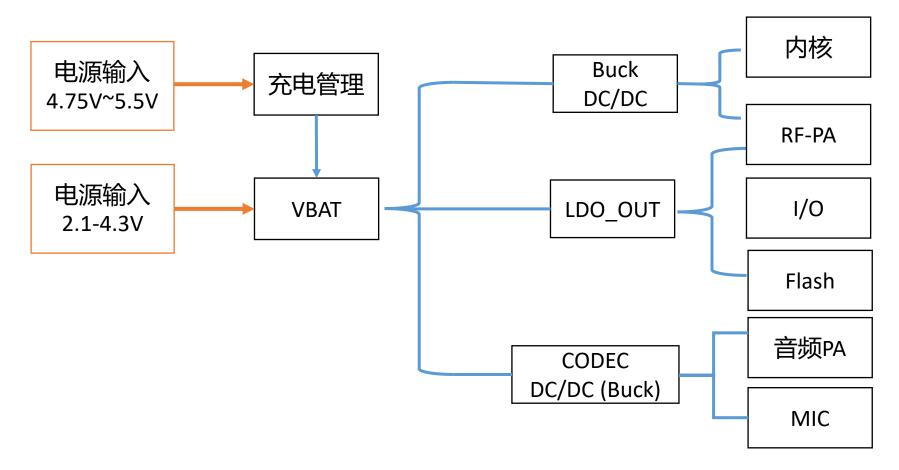
- SDC
- USB-OTG
- 支持音频EQ调节
- 两路QSPI (104x4Mbps)



FR508x框图

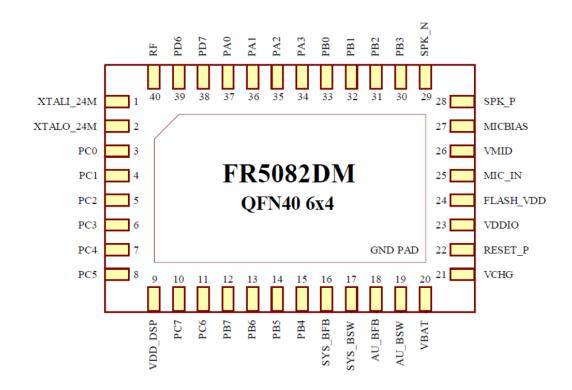


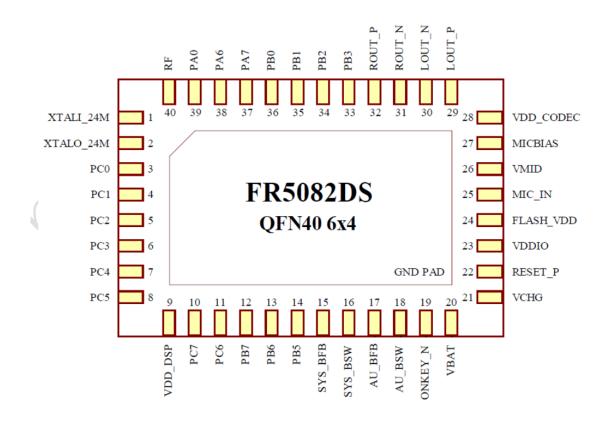
FR508x电源结构



FR508x型号及封装

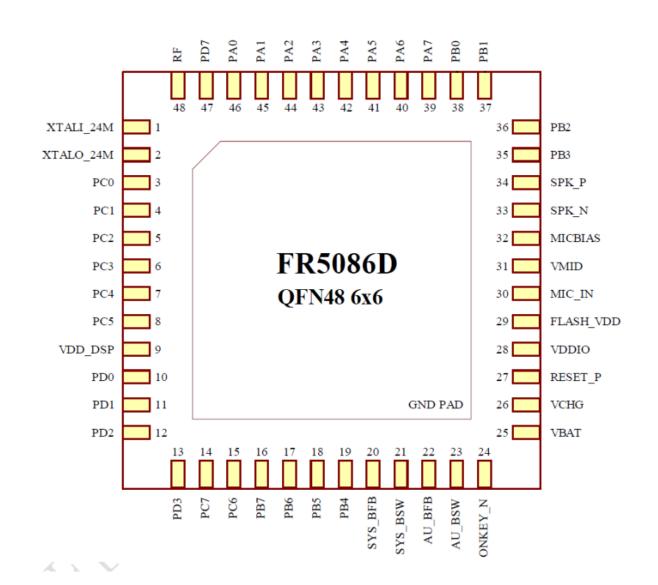
1、FR5082DM/DS





FR508x型号及封装

2、FR5086D



FR508x应用设计注意事项

1、电源部分和时钟

- A、芯片供电输入只能从VBAT脚输入,输入电压范围为2.7V~4.3V。
- B、芯片电源滤波电容在PCB Layout时靠近芯片引脚放置,滤波电容地就近接芯片底部焊盘地。
- C、应用中不使用的引脚悬空。
- D、DC/DC Buck降压电感选用10uH、额定电流≥80mA、Rdc值小于1Ω、频率≥ 10MHz。可使用叠层电感、线绕电感。
- E、VCHG脚滤波电容选用耐压≥ 25V; VBAT脚滤波电容选用耐压≥ 10V; 其它电源脚滤波电容耐压选用6.3V。
- F、VDDIO输出电压可配置,最大支持80mA输出电流,可供外设使用。
- G、复位脚RSTP为高电平复位。触发复位电平≥0.8V,时间≥3uS。
- H、VBAT脚内置电压检测。
- E、晶振选用24MHz、CL值≤12pF、10ppm。

FR508x应用设计注意事项

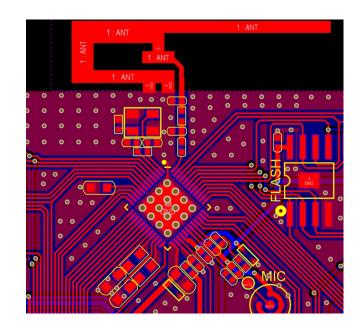
2、I/O部分

- A、PB6 加上拉电阻10K,稳定系统启动。当做USB功能时,上拉电阻阻值改为1.5K。
- B、产品需要过静电2KV以上测试,接口处使用的I/O需增加TVS管或者ESD管。
- C、所有I/O上电默认浮空状态。需要上电默认输出低电平,需在I/O增加下拉电阻。
- D、软件烧录口使用串口(PB6、PB7)PCB Layout需留VBAT、PB6、PB7、GND测试点。
- E、PB4~PB7支持SAR ADC。
- F、PC6、PC7可用于DSP串口调试。
- G、I/O驱动电流8mA。
- H、DSP控制I/O时,设计时注意避免I/O冲突(DSP只能控制DSPIO0~DSPIO78个I/O)。
- I、外挂QSPI Flash时, Flash芯片靠近主控管脚芯片放置,走线尽量短,有空间尽量走等长线。

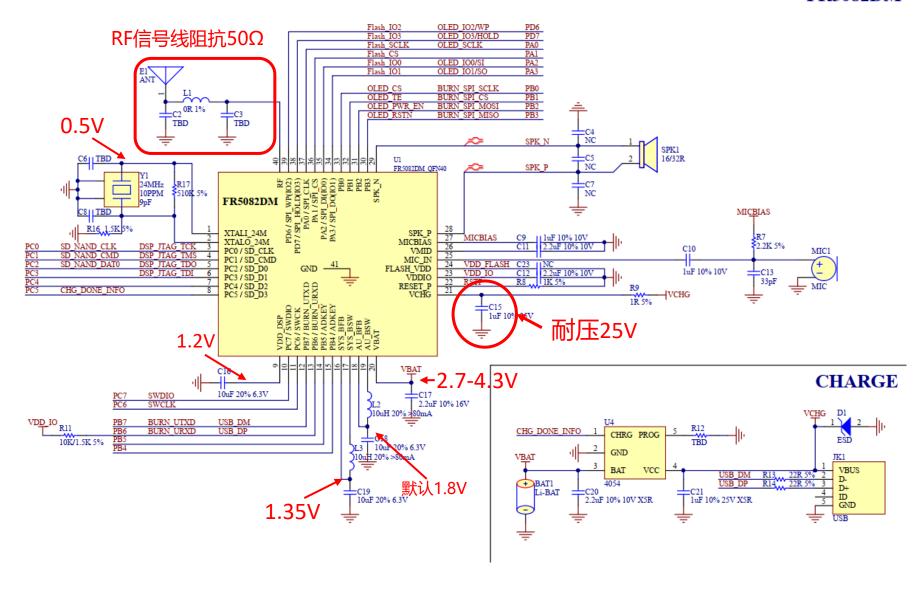
FR508x应用设计注意事项

3、RF部分

- A、天线必须放置在板边,严禁被GND包裹,且正反面需要净空区,远离金属和电池,远离高频噪声源。
- B、射频线需要走50ohm阻抗。走线尽量短和宽,不要有过孔,最好和芯片同层。不能走直角,尽量使用圆弧 走线或135°角走线,走线宽度保持一致,避免分支走线,周围地孔屏蔽。确保射频走线底层有完整的地平面, 并且与芯片底部的GND相连。
- C、天线与芯片之间预留π形匹配电路,靠近芯片RF脚放置,用于天线匹配,天线匹配阻抗往50Ω方向调,元
- 件参数值根据天线和PCB布局实测后确定。



FR5082DM



FR800x硬件资源

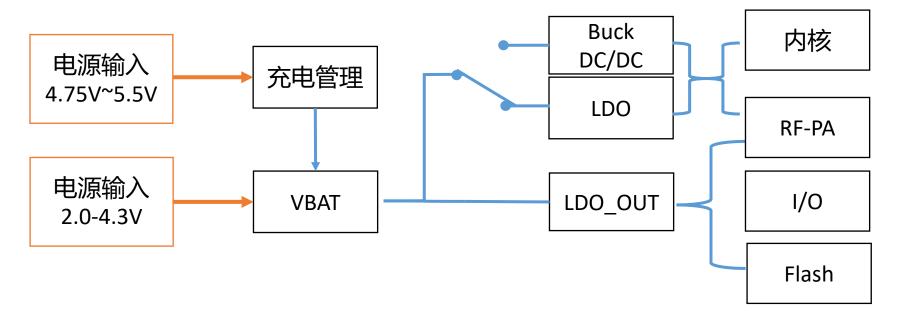
MCU特性

- ARM Cotex-M3内核
- 96MHz主频
- 56KB SRAM
- 512KB/1MB/8MB/16MB Flash
- 两路UART
- 支持2路数字MIC
- 1路模拟MIC
- 两路SPI, 支持主、从
- 两路QSPI
- 两路I2C
- Timer
- 8路PWM
- 内置RTC时钟
- 8路10位SAR ADC
- 所有I/O支持唤醒
- I/O内置上、下拉电阻(上拉10K、下拉6.5K),默认浮空状态
- 支持USB OTG

- 支持SPI、QSPI、MCU8080(8bit、16bit)显示屏接口
- 部分型号内置2MB PSRAM
- 支持DMA控制
- BLE V5.1标准



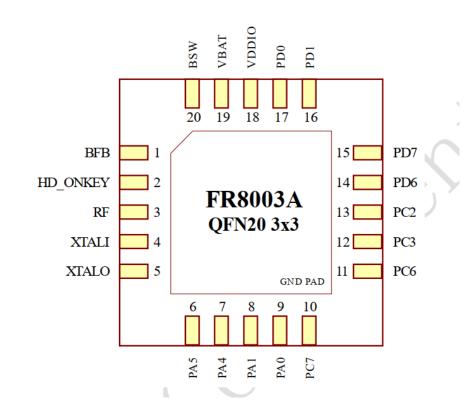
FR800x电源结构

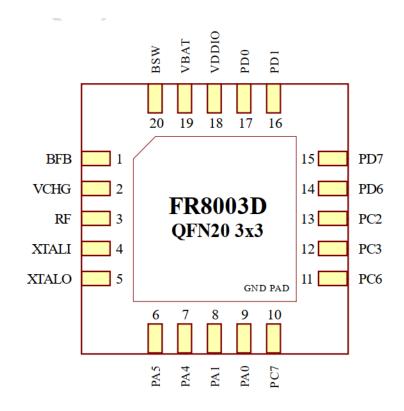




FR800X型号及封装

1、FR8003A/D

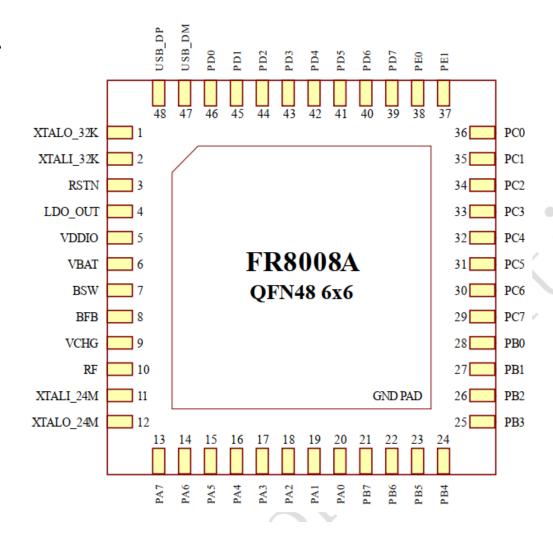






FR800X型号及封装

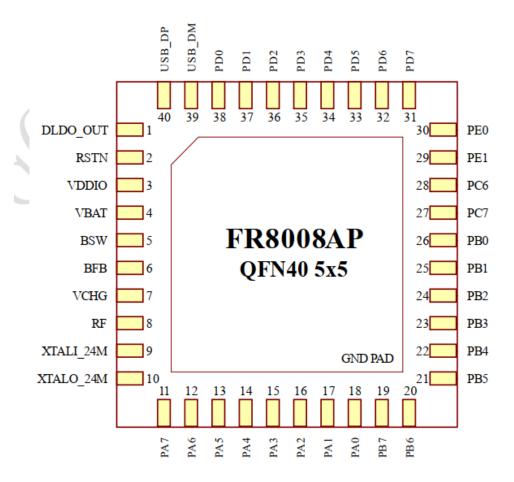
2、FR8008A

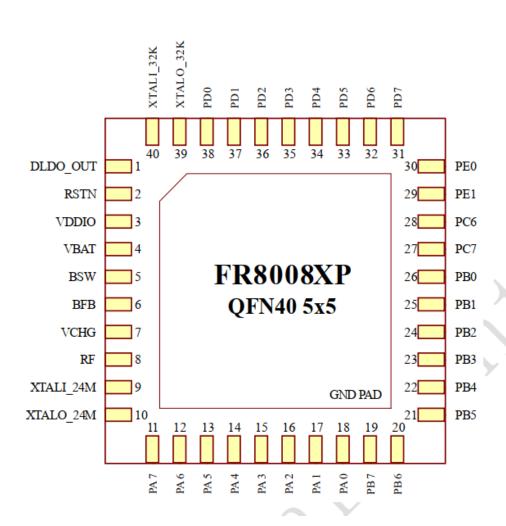




FR800X型号及封装

3、FR8008AP/XP







FR800X应用设计注意事项

1、电源部分和时钟

- A、芯片供电输入只能从VBAT脚输入,输入电压范围为2.0V~4.3V。
- B、芯片电源滤波电容在PCB Layout时靠近芯片引脚放置,滤波电容地就近接芯片底部焊盘地。
- C、应用中不使用的引脚悬空。
- D、DC/DC Buck降压电感选用10uH、额定电流≥50mA、Rdc值小于1Ω、频率≥ 10MHz。可使用叠层电感、线绕电感。
- E、VCHG脚滤波电容选用耐压≥ 25V; VBAT脚滤波电容选用耐压≥ 10V; 其它电源脚滤波电容耐压选用6.3V。
- F、VDDIO输出电压可配置,最大支持100mA输出电流,可供外设使用。
- G、复位脚RSTN为低电平复位。
- H、VBAT脚内置电压检测。
- E、晶振选用24MHz、CL值≤12pF、10ppm。



FR800X应用设计注意事项

2、I/O部分

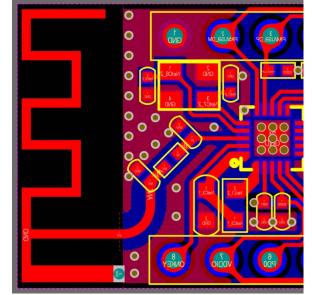
- A、PAO 加上拉电阻10K,稳定系统启动。当做USB功能时,上拉电阻阻值改为1.5K。
- B、产品需要过静电2KV以上测试,接口处使用的I/O需增加TVS管或者ESD管。
- C、所有I/O上电默认浮空状态。需要上电默认输出低电平,需在I/O增加下拉电阻。
- D、软件烧录口使用串口(PAO、PA1)PCB Layout需留VBAT、PAO、PA1、GND测试点。
- E、PD0~PD7支持SAR ADC。
- F、PC6、PC7可用于J-Link调试。
- G、I/O驱动电流8mA。
- H、外挂QSPI Flash时,Flash芯片靠近主控管脚芯片放置,走线尽量短,有空间尽量走等长线。



FR800X应用设计注意事项

3、RF部分

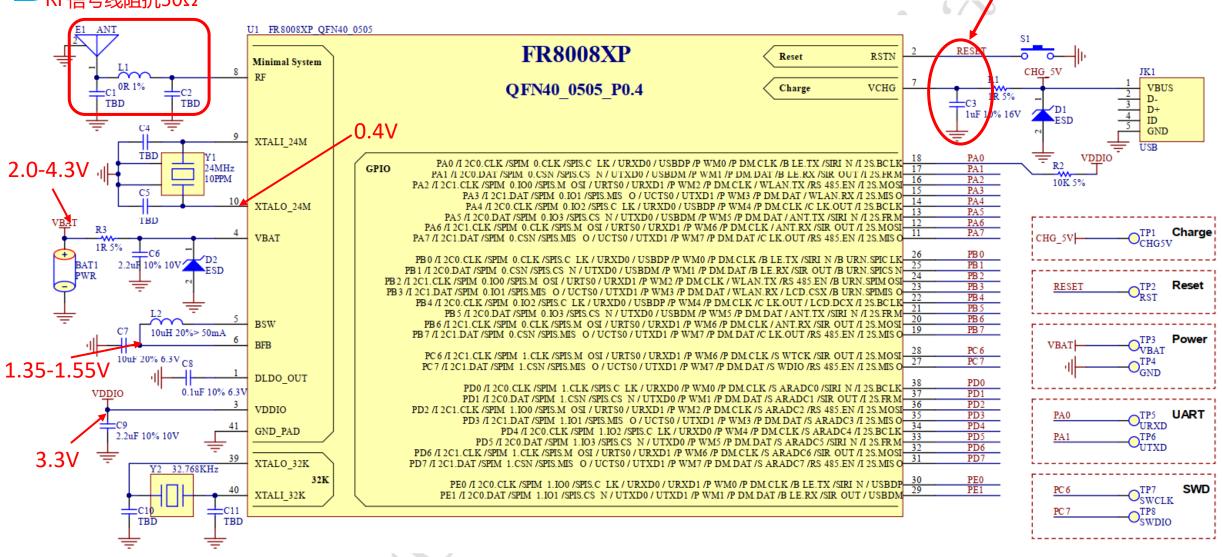
- A、天线必须放置在板边,严禁被GND包裹,且正反面需要净空区,远离金属和电池,远离高频噪声源。
- B、射频线需要走50ohm阻抗。走线尽量短和宽,不要有过孔,最好和芯片同层。不能走直角,尽量使用圆弧 走线或135°角走线,走线宽度保持一致,避免分支走线,周围地孔屏蔽。确保射频走线底层有完整的地平面, 并且与芯片底部的GND相连。
- C、天线与芯片之间预留π形匹配电路,靠近芯片RF脚放置,用于天线匹配,天线匹配阻抗往50Ω方向调,元件参数值根据天线和PCB布局实测后确定。





FR800X硬件调试

RF信号线阻抗50Ω



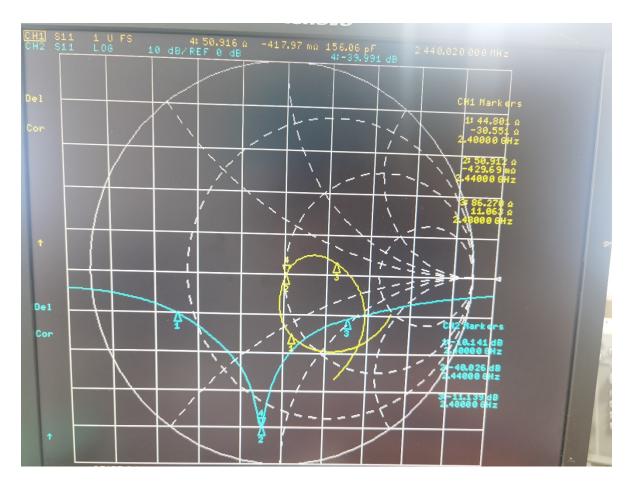
耐压25V



RF信号、频偏调试

1、RF信号

主要调试天线阻抗与芯片RF阻抗相同。使用仪器: 网络分析仪

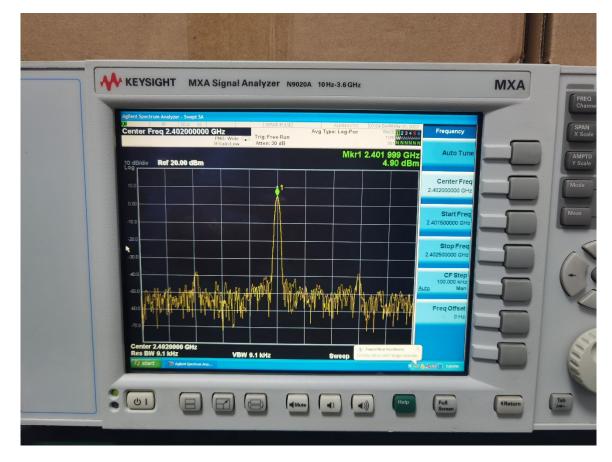




RF信号、频偏调试

1、频偏测试

调试信号工作在指定频点上,偏差+/-30kHz。使用仪器: 频谱分析仪 烧录定频测试软件测试



联系我们



上海 张江高科技园区碧波路912弄华依创新园8号楼5楼

青岛 青岛市崂山区科苑纬一路1号国际创新园D2座16层

深圳 宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创意园A座530室

www.freqchip.com

sales@freqchip.com

21-50270080



微信公众号